1. 中兴：

岗位：软件工程师

面试过程：简历筛选+笔试+两轮面试

笔试：选择（Linux、c/c++、网络协议、数据结构）+判断+两道编程（c语言）

 难度：适中

面试：两轮面试我都介绍了自己的项目，面试官问了一些基础知识，然后就问了我一下STM32的启动方式，程序下载过程等等；第二轮面试主要问自己的工作地点，性格缺陷之类的问题；

1. 诺瓦科技：

岗位：嵌入式软件工程师(MCU)

过程：简历筛选+笔试+三轮面试

笔试：程序补充+选择+填空（单片机，Linux、c/c++、网络协议，数据结构）

 难度：简单

面试：第一轮面试：（技术面）我介绍了自己的单片机项目，面试官很感兴趣，一直问我技术性的问题，FSMC，I2C，SPI，LTDC等等。然后又问了C/C++，LINUX的基础性问题。第二轮面试：（综合面）主要问自己最大的优缺点，遇到的困难，怎么解决，等等一系列的问题。第三轮面试：（HR面）很轻松，就是聊天，确定你是否会来公司，介绍他们公司的产品，总结你前两轮面试的情况，优点和缺点等等；

1. CVTE：

岗位：嵌入式软件工程师

过程：笔试+四轮面试

笔试：20道选择+2道编程（单片机，Linux、c/c++、网络协议，数据结构）

 难度：简单

面试：第一轮面试：（电话技术面）直接问C/C++，LINUX的一些问题，指针，引用，继承，虚函数，内存管理等等，（他会一直问你，直到你不会）。第二轮面试：（视频技术面）直接问C/C++，LINUX的一些问题，然后让我写一段程序，判断大小端绪；第三轮面试：（hr视频面）主要问自己的一些兴趣爱好，优缺点，给前两轮面试打分，为什么打这样的分数，喜欢的城市等等。第四轮面试：（hr线下面试）8个应聘者一起被面试，每个人说自己的职业规划，除了学习专业知识，还学习了什么，本行业最前沿的技术。

1. 海康威视：

岗位：嵌入式软件工程师（BSP）

过程：笔试+三轮面试

笔试：20道选择+1道编程（Linux、c/c++、网络协议TCP，数据结构）

 难度：简单

面试：第一轮面试：（电话面试）直接问最近做的项目，就没有然后了。第二轮面试：（视频技术面试）整个面试过程挺简单的，给我了几道程序题，问我输出结果，主要是结构体大小，内存地址对齐，字符串的大小，sizeof，strlen相关的题目。第三轮面试：（线下综合面试）问我什么不考研，怎么弥补以后工作中和研究生的差距，自己理想工作地点，自己比其他人的优点，举例说明。

1. 小米：

岗位：相机软件工程师

过程：两轮面试（提前批）

面试：第一轮面试：（视频技术面）他十分感兴趣我的项目，我做了一个电流信号检测的装置，他让我画框图，然后给我找各种难题，问我这个地方我还有没有更好的办法，我如果只用软件的话，怎么修改，如果只用硬件的话，怎么修改，然后问我了一些基础的问题，最后让我手撕代码。第二轮面试：（视频技术综合面）还是主要问技术的一些问题，指针，数组，Linux等等，然后给我了一段英文的数据手册让我翻译，然后让我手撕两个代码，一个数据结构的题目，一个回文数的问题。